# SEALING MATERIAL COMPOSITION FOR LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT AND LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT FORMED BY USING THE SAME

Patent number:

JP10003084

**Publication date:** 

1998-01-06

Inventor:

MORI TETSUYA

Applicant:

SUMITOMO BAKELITE CO

Classification:

- international:

C08G59/40; G02F1/1339; C08G59/00; G02F1/13;

(IPC1-7): G02F1/1339; C08G59/40

- european:

Application number: JP19960156491 19960618 Priority number(s): JP19960156491 19960618

Report a data error here

#### Abstract of JP10003084

PROBLEM TO BE SOLVED: To make it possible to maintain an adequate gap by completing initial curing under specific conditions under panel pressurization and to complete post-curing under specific conditions by using a chief material contg. a specific oligomer, a hardener and an inorg. filler as essential component. SOLUTION: The oligomer having respectively >=1 radical reactive functional groups and epoxy groups in one molecule has radical reactivity and addition reactivity by the epoxy group in combination in the molecule. The radicals generated under the conditions of 120 to 150 deg.C/5 minutes under panel pressurization react like chains and curing progresses to the extent that a cell gap can be assured. Further, the epoxy groups which hardly contribute to the reaction ion the initial curing complete the addition reaction under the conditions of 150 to 250 deg.C/1 hour. The hardener contains org. peroxide and a compd. Which makes addition reaction with the epoxy groups as essential components. Further, the amt. of the inorg. filter to be added is specified to 3 to 50wt.% of the entire compsn.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-3084

(43)公開日 平成10年(1998)1月6日

| (51) Int.Cl. <sup>6</sup> |        | 識別記号 | 庁内整理番号 | FΙ      |        |     | 技術表示箇所 |
|---------------------------|--------|------|--------|---------|--------|-----|--------|
| G02F                      | 1/1339 | 505  |        | G 0 2 F | 1/1339 | 505 |        |
| C 0 8 G                   | 59/40  | NHX  |        | C08G    | 59/40  | NHX |        |

### 審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 5 頁)

| (21)出願番号 | <b>特顧平8-156491</b> | (71) 出願人                                | 000002141<br>住友ペークライト株式会社          |  |
|----------|--------------------|---|------------------------------------|--|
| (22)出顧日  | 平成8年(1996)6月18日    | (72)発明者                                 | 東京都品川区東品川2丁目5番8号森 哲也               |  |
|          |                    | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 東京都品川区東品川2丁目5番8号 住友<br>ペークライト株式会社内 |  |

### (54) [発明の名称] 液晶表示素子用シール材組成物及びそれを用いた液晶表示素子

### (57)【要約】

【課題】 パネル加圧下で120~150℃/5分の条件で初期硬化を完了して適正ギャップを保持し、更に150~250℃/1時間という短時間の条件で後硬化を完了できることを特徴とする液晶シール材組成物を提供する。

【解決手段】 (A) 1 分子中にラジカル反応性の官能 基とエポキシ基とをそれぞれ一つ以上有するオリゴマーを含有する主剤、(B) 硬化剤及び(C) 無機充填材を主成分とすることを特徴とする液晶表示素子用シール材 組成物。

#### 【特許請求の範囲】

(A) 1分子中にラジカル反応性の官能 【請求項1】 基とエポキシ基とをそれぞれ一つ以上有するオリゴマー を含有する主剤、(B)硬化剤及び(C)無機充填材を 主成分とすることを特徴とする液晶表示素子用シール材 組成物。

【請求項2】 ラジカル反応性の官能基がアクリロイル 基及び/又はメタクリロイル基であることを特徴とする 請求項1記載の液晶表示素子用シール材組成物。

【請求項3】 キシ基と付加反応を行う化合物とを必須成分として含有 することを特徴とする請求項1記載の液晶表示素子用シ ール材組成物。

【請求項4】 請求項1から3のいずれか1項に記載の 液晶表示素子用シール材組成物を用いた液晶表示素子。 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は液晶表示素子用シー ル材組成物及びそれを用いた液晶表示素子に関するもの である。

#### [0002]

【従来の技術】近年、軽量、薄型、低消費電力等の特徴 から液晶表示素子が広く普及している。液晶表示素子 は、配向処理を施された二枚のガラス、あるいはプラス チックの基板の外周部を接着剤により圧着封止してお り、一般にこれを液晶表示素子用シール材(略して液晶 シール材)と呼んでいる。現在、この液晶シール材は硬 化物の電気的信頼性に優れることから広くエポキシ樹脂 を主体としたものが用いられている(例えば特開昭59 -126511号公報)。近年液晶パネルメーカーでは 30 パネルの大画面化が進行しておりこれに伴いLCDのよ り一層の生産性向上の努力が続けられている。従来より もパネルサイズが大きくなるに従い、ギャップ精度保持 の観点から、とれまでのように貼り合わされた二枚のガ ラス基板を積み重ねて加熱を行う多段加圧硬化方式が困 難になってきている。その結果、貼り合わされた二枚の ガラス基板を一組づつ加圧して加熱を行う枚葉硬化方式 に移行されつつある。又、それに伴い液晶シール材もパ ネルの生産性向上の為に、従来品より短時間で硬化でき るものが強く求められている。従来のシール材硬化条件 40 とする液晶シール材組成物を提供するものである。 はパネル加圧下で160~180℃、2時間というもの が一般的であった。しかしながら、これまでのところ現 状のプロセスよりも短時間硬化を追い求めたものは、従 来のエポキシ樹脂を主体とした材料系に、単純にエポキ シ基の開環を促す硬化促進剤を増量したものが多く、室 温におけるシール材の保存安定性及び液晶が注入された 後のセルの電気的信頼性(電圧保持率、残留DC電圧、 消費電流値等)に劣るものが多い。又、エポキシ基が無 くてアクリロイル基やメタクリロイル基を持つ樹脂を用 いて材料化したものについては、ラジカル硬化が試みら 50 をそれぞれ一つ以上有するオリゴマーは、分子中にラジ

れてきた。ラジカルの発生源としては、UV等により分 子内開裂を引き起としてラジカルを生成する光開始剤が 用いられてきた(例えば特開昭56-53169、特開 平5-295087号公報)。しかしながらシール材は 系内に無機の充填材を多く含んでいるために、UV光が シール材最深部にまで透過しにくい。その為、光開始剤 から十分なラジカルが供給されず結果として未反応の樹 脂分が残存して液晶セルの電気的信頼性を低下させる場 合が多い。又、有機過酸化物をラジカル発生源として用 (B)硬化剤が、有機過酸化物と、エポ 10 いて、加熱によりラジカル反応を進行させるよう材料設 計をすることも可能であるが、この場合においても、依 然として樹脂の硬化度が通常のエポキシ樹脂の付加反応 で得られるそれよりも低い為に、シール材の接着性が不 十分であったり、液晶セルの電気特性に著しい弊害を与 える場合がある。とのように保存性、硬化性、電気特性 等が総合的にバランスのとれた速硬化性の材料は未だ上 市されていない。

> 【0003】一方、本発明者らは、エポキシ樹脂中に単 純にラジカル反応性の樹脂をブレンドしたもので材料化 20 を行い120~150℃/5分の条件で液晶シール材の 硬化を行ったところ、接着性については顕著な差は見ら れないものの、液晶セルの電気的信頼性が格段に低いて とが判明した。この原因について詳細に検討した結果、 120~150℃/5分の硬化条件で架橋に関与しなか ったラジカル反応性の樹脂が液晶シール材硬化物から液 晶中へブリードしていることが判明した。これに対し、 分子中にラジカル反応性の官能基とエポキシ基をそれぞ れ少なくとも一つ以上併せ持つオリゴマーは、たとえ架 橋に関与しないアクリロイル基及びメタクリロイル基が 存在しても、同一分子内にエポキシ基を保有しているた めに150℃~250℃/1時間の硬化条件により最終 的に架橋構造に取り込まれ、樹脂が液晶中にブリードす ることは無く高い電気的信頼性が得られることを見いだ し本発明に至った。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、パネル加圧 下で120~150℃/5分の条件で初期硬化を完了し て適正ギャップを保持し、更に150~250℃/1時 間という短時間の条件で後硬化を完了できることを特徴

#### [0005]

【課題を解決するための手段】本発明は(A) 1分子中 にラジカル反応性の官能基とエポキシ基とをそれぞれ一 つ以上有するオリゴマーを含有する主剤、(B)硬化剤 及び(C)無機充填材を主成分とすることを特徴とする 液晶表示素子用シール材組成物である。

#### [8000]

【発明の実施の形態】本発明で必須成分として用いられ る、1分子中にラジカル反応性の官能基とエポキシ基と

3

カル反応性とエポキシ基による付加反応性を兼ね備えて いる。とのため重合開始剤として用いられた有機過酸化 物から、パネル加圧下120~150℃/5分の条件で 発生したラジカルが連鎖的に反応してセルギャブが確保 出来る程度まで硬化が進行する。このオリゴマーの配合 量としては全樹脂中、10重量部以上100重量部以 下、好ましくは20重量部以上90重量部以下、更に好 ましくは30重量部以上80重量部以下である。この配 合量が10重量部未満の場合にはパネル加圧下120~ 150℃/5分の条件で十分な初期接着力が得られず、 液晶パネルのギャップが保持できず好ましくない。更に 初期硬化では反応にほとんど関与しなかったエポキシ基 が150℃~250℃/1時間の条件で付加反応を完了 する。

【0007】本発明で用いる、1分子中にラジカル反応 性の官能基とエポキシ基とをそれぞれ一つ以上有するオ リゴマーにおけるラジカル反応性の官能基は、アクリロ イル基及び/又はメタクリロイル基であることが好まし い。本発明で用いる、同一分子中にラジカル反応性の官 能基とエポキシ基をそれぞれ少なくとも一つ以上併せ持 20 つオリゴマーは、エポキシ基の一部を例えばアクリロイ ル基及び/又はメタクリロイル基により変性することに より得られる。変性前の前駆体であるエポキシ樹脂の種 類については特に限定されないが、例えばビスフェノー ルA型エポキシ樹脂、アルキル置換ビスフェノールA型 エポキシ樹脂、ビスフェノールF型エポキシ樹脂、アル キル置換ビスフェノールF型エポキシ樹脂、ビスフェノ ールS型エポキシ樹脂、グリシジルアミン型エポキシ樹 脂、フェノールノボラック型エポキシ樹脂、クレゾール ノボラック型エポキシ樹脂、ピフェニル型エポキシ樹 脂、ナフタレン型エポキシ樹脂、ジシクロペンダジエン 型エポキシ樹脂、グリシジルエステル型エポキシ樹脂、 脂環式エポキシ樹脂、ウレタン変性エポキシ樹脂等があ

【0008】硬化剤は、有機過酸化物と、エポキシ基と 付加反応を行う化合物とを必須成分として含有すること が好ましい。本発明で用いられる有機過酸化物は特に限 定されないが、例えばジアシルパーオキサイド、パーオ キシジカーボネート、パーオキシエステル、パーオキシ ケタール、ジアルキルバーオキサイド、ハイドロパーオ 40 い。 キサイド等があり1種もしくは2種以上併用して用いら れる。又、エポキシ基と付加反応を行う化合物として は、アミン系硬化剤、イミダゾール系硬化剤、ジシアン ジアミド、ヒドラジド型硬化剤、酸無水物型硬化剤、フ ェノール系硬化剤等が使用可能であり、更にこれらに硬 化促進剤を併用することも出来る。硬化促進剤として は、リン系化合物、3級アミン、イミダゾール系化合 物、尿素型化合物等が一般に使用される。

【0009】又、無機充填材としては、例えば、各種金

カリウム等が挙げられこれらの中で種々の点からアルミ ナ、シリカを一種または二種以上併用して使用されると とが好ましい。更に無機充填材の添加量としては、印刷 性等の作業性の点から全組成物のうち3~50重量%と することが好ましい。

【0010】又、シール材組成物の粘度調整、各成分の 均一混合の目的で必要に応じて溶剤を添加しても良い。 用いる種類については特に制限はないが、例えばn-へ キサン、n-デカン、シクロヘキサン等の炭化水素系溶 10 剤、ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族系炭化水 素系溶剤、ブチルアセテート、ベンジルアセテート等の エステル系溶剤、メチルセロソルブ、ブチルセロソル ブ、メチルカルビトール、エチルカルビトール、ブチル カルビトール、メチルセロソルブアセテート、エチレン グリコール、ジエチレングリコール、ジグライム等の多 価アルコール及びその誘導体等が一種あるいは二種以上 併用されて用いられる。溶剤の添加量については印刷性 等の点から全組成物のうち2~50重量%とすることが 好ましい。

【0011】更に、溶剤の他に必要に応じてカップリン グ剤、消泡剤、レベリング剤等を添加しても良い。本発 明の液晶シール材を調整する際は、各成分を均一に混合 させるために3本ロール等を用いて混練することが好ま

【0012】本発明の液晶シール材を用いて液晶表示素 子を製造する方法としては、一般に以下のような方法が 用いられる。先ず、液晶配向層を形成したガラス及びプ ラスティック基板の一方に、スクリーン印刷等の工程に よりシールパターンを形成する。液晶シール材組成中に 30 溶剤を含むために乾燥炉等で予備乾燥させた後、もう一 方の基板を貼り合わせて加圧し、更に乾燥炉等で120 ~150℃/5分の条件で初期硬化を終えて液晶パネル の適正ギャップ保持を行う。この後、圧力を解除した状 態で更に150℃/1時間の条件で後硬化を完了させ る。この貼り合わせた基板に液晶を注入し、注入口をU V硬化樹脂等で封じて液晶表示素子とする。

[0013]

【実施例】以下に本発明の実施例を説明するが、本発明 はとれらの実施例によって何ら限定されるものではな

【0014】(実施例1)エポキシ樹脂としてジシクロ ペンタジエン型エポキシ樹脂(大日本インキ化学工業社 製、HP-7200) 50重量部、ビスフェノールA型 エポキシ樹脂(油化シェルエポキシ社製、エピコート8 28) 10重量部、同一分子中にアクリロイル基とエポ キシ基を両末端に各々一つづつ併せ持つオリゴマー(昭 和高分子社製、SP-1509H)40重量部、硬化剤 としてアジピン酸ジヒドラジド(以下、ADHと略す) (大塚化学社製) 7重量部、有機過酸化物として t - ブ 属の炭酸塩、アルミナ、シリカ、酸化チタン、チタン酸 50 チルパーオキシベンゾエート(日本油脂社製、パープチ 5

ル2)3重量部、硬化促進剤としてアミンアダクト型ポリマー化合物であるアミキュアPN-R(味の素社製)2重量部、無機充填材として無定型シリカ(日本アエロジル社製、アエロジルR-972)5重量部、アルミナ(昭和電工社製、UA-5105)30重量部、溶剤としてエチルジグライム15重量部を攪拌混合し、更に三本ロールで十分に混練して接着剤組成物を得た。

【0015】次に、この接着剤組成物に直径6μmのロッド状スペーサーを1%混合し、以下の要領で液晶セルを作製した。

(スクリーン印刷) 300メッシュの版を用いて配向膜を形成させたITO付きガラス基板上(一辺3cmの正方形) に線幅が0.3mmの正方形のパターンをスクリーン印刷した。

(予備乾燥) 熱風乾燥中、90℃/30分予備乾燥した。

(貼り合わせ/加熱硬化) 配向膜を形成させた I TO付\*

\* きガラス基板を、配向方向がシール材を印刷した基板の配向処理方向に対して90度になるように貼り合わせ、1 kg/cm²の圧力をかけた状態で熱風乾燥機中140°C/5分初期硬化させた。これを室温まで冷却し、圧力を解除した状態で150°C/1時間、後硬化を行った。尚、評価セルは各n=10作製した。

(液晶注入/封口)フッソ系液晶(メルク社製、ZLI-4792)を注入し、注入口をアクリル系UV硬化樹脂で封口した。

10 【0016】評価は次のように行った。125°C/2. 3 atmに設定したブレッシャークッカー試験器に12h r、上記液晶表示素子を放置。処理が終わった後、この 液晶セルの電圧保持率及びシール部分の剥離の有無を確 認した。評価の結果は表1に示す通りである。

【0017】 【表1】

|       | 電圧保持率(%) | シール部副離の有無 |
|-------|----------|-----------|
| 実施例1  | 98       | 無し        |
| 実施例2  | 98       | 無し        |
| 実施例3  | 98       | 無し        |
| 比較例 1 | 8 2      | 有り        |
| 比較例 2 | 8 5      | 有り        |
| 比較例3  | 8 3      | 有り        |

【0018】 (実施例2) エポキシ樹脂としてジシクロ ペンタジェン型エポキシ樹脂(大日本インキ化学工業社 30 製、HP-7200) 40重置部、ビスフェノールA型 エポキシ樹脂(油化シェルエポキシ社製、エピコート1 001)20重量部、同一分子中にアクリロイル基とエ ポキシ基を両末端に各々一つづつ併せ持つオリゴマー (昭和高分子社製、SP-1509H)40重量部、硬 化剤としてADH (大塚化学社製) 7 重量部、有機過酸 化物としてクメンハイドロパーオキサイド(日本油脂社 製、パークミルH) 4重量部、硬化促進剤としてアミン アダクト型ポリマー化合物であるアミキュアMY-R (味の素社製) 2重量部、無機充填材として無定型シリ カ(日本アエロジル社製、アエロジルR-972)5重 量部、アルミナ(昭和電工社製、UA-5105)30 重量部、溶剤としてエチルジグライム20重量部を攪拌 混合し、更に三本ロールで十分に混練して接着剤組成物 を得た。評価の結果は表1に示す通りである。

【0019】(実施例3)エポキシ樹脂としてナフタレン型エポキシ樹脂(大日本インキ化学工業社製、HP-4032)40重量部、ビスフェノールA型エポキシ樹脂(油化シェルエポキシ社製、エピコート1001)2 0重量部、同一分子中にメタクリロイル基とエポキシ基50

を両末端に各々一つづつ併せ持つオリゴマー(日本油脂社製、ブレンマーGH)40重量部、硬化剤としてジシアンジアミド(日本カーバイド社製)10重量部、有機過酸化物としてtーブチルバーオキシ2-エチルヘキサノエート(日本油脂社製、パーブチルO)4重量部、硬化促進剤としてアミンアダクト型ポリマー化合物であるアミキュアMY-R(味の素社製)2重量部、無機充填材として無定型シリカ(日本アエロジル社製、アエロジルR-972)5重量部、アルミナ(昭和電工社製、UA-5105)30重量部、溶剤としてエチルジグライム20重量部を攪拌混合し、更に三本ロールで十分に混練して接着剤組成物を得た。評価の結果は表1に示す通りである。

【0020】(比較例1) エポキシ樹脂としてジシクロペンタジエン型エポキシ樹脂(大日本インキ化学工業社製、HP-7200)50重量部、ビスフェノールA型エポキシ樹脂(油化シェルエポキシ社製、エビコート828)10重量部、3-シクロヘキセニルメチルアクリレート(ダイセル工業社製、CHAA)40重量部、硬化剤としてADH(大塚化学社製)7重量部、有機過酸化物としてt-ブチルパーオキシベンゾエート(日本油脂社製、パーブチルZ)3重量部、硬化促進剤としてア

7

ミンアダクト型ポリマー化合物であるアミキュアPN-R(味の素社製)2重量部、無機充填材として無定型シリカ(日本アエロジル社製、アエロジルR-972)5重量部、アルミナ(昭和電工社製、UA-5105)30重量部、溶剤としてエチルジグライム15重量部を攪拌混合し、更に三本ロールで十分に混練して接着剤組成物を得た。

【0021】(比較例2)エポキシ樹脂としてジシクロ ペンタジェン型エポキシ樹脂(大日本インキ化学工業社 製、HP-7200) 40重量部、ビスフェノールA型 エポキシ樹脂(油化シェルエポキシ社製、エピコート1 001)20重量部、末端にカルボキシル基を有するラ クトン変性アクリレート(ダイセル化学工業社製、プラ クセルFM1A) 40重量部、硬化剤としてADH(大 塚化学社製) 7 重量部、有機過酸化物としてクメンハイ ドロパーオキサイド(日本油脂社製、パークミルH) 4 重量部、硬化促進剤としてアミンアダクト型ポリマー化 合物であるアミキュアMY-R (味の素社製)2重量 部、無機充填材として無定型シリカ(日本アエロジル社 製、アエロジルR-972)5重量部、アルミナ(昭和 電工社製、UA-5105)30重量部、溶剤としてエ チルジグライム20重量部を攪拌混合し、更に三本ロー ルで十分に混練して接着剤組成物を得た。評価の結果は 表1に示す通りである。

【0022】(比較例3)エポキシ樹脂としてナフタレ ン型エポキシ樹脂(大日本インキ化学工業社製、HP-4032) 40重量部、ビスフェノールA型エポキシ樹 脂(油化シェルエポキシ社製、エピコート1001)2 0重量部、アリルメタクリレート (ダイセル化学工業社 製、ALMA) 40重量部、硬化剤としてジシアンジア ミド(日本カーバイド社製)10重量部、有機過酸化物 として t - プチルパーオキシ 2 - エチルヘキサノエー ト (日本油脂社製、パーブチル〇) 4 重量部、硬化促進 10 剤としてアミンアダクト型ポリマー化合物であるアミキ ュアMY-R (味の素社製)2重量部、無機充填材とし て無定型シリカ(日本アエロジル社製、アエロジルR-972)5重量部、アルミナ(昭和電工社製、UA-5 105) 30重量部、溶剤としてエチルジグライム20 重量部を攪拌混合し、更に三本ロールで十分に混練して 接着剤組成物を得た。評価の結果は表1に示す通りであ

8

#### [0023]

【発明の効果】本発明によれば、パネル加圧下で120 20 ~150℃/5分の条件で初期硬化を完了して適正ギャップを保持し、更に150~250℃/1時間という短時間の条件で後硬化を完了でき液晶パネルの生産性向上を図ることが出来る。

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-003084

(43)Date of publication of application: 06.01.1998

(51)Int.CI.

G02F 1/1339 C08G 59/40

(21)Application number: 08-156491

(71)Applicant: SUMITOMO BAKELITE CO LTD

(22)Date of filing:

18.06.1996

(72)Inventor: MORI TETSUYA

# (54) SEALING MATERIAL COMPOSITION FOR LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT, AND LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT FORMED BY USING THE SAME

#### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To make it possible to maintain an adequate gap by completing initial curing under specific conditions under panel pressurization and to complete post-curing under specific conditions by using a chief material contg. a specific oligomer, a hardener and an inorg, filler as essential component.

SOLUTION: The oligomer having respectively ≥1 radical reactive functional groups and epoxy groups in one molecule has radical reactivity and addition reactivity by the epoxy group in combination in the molecule. The radicals generated under the conditions of 120 to 150° C/5 minutes under panel pressurization react like chains and curing progresses to the extent that a cell gap can be assured. Further, the epoxy groups which hardly contribute to the reaction ion the initial curing complete the addition reaction under the conditions of 150 to 250° C/1 hour. The hardener contains org. peroxide and a compd. Which makes addition reaction with the epoxy groups as essential components. Further, the amt. of the inorg. filter to be added is specified to 3 to 50wt.% of the entire compsn.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

07.02.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C), 1998,2003 Japan Patent Office

#### \* NOTICES \*

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original

2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

#### **CLAIMS**

[Claim(s)]

[Claim 1] (A) The sealant constituent for liquid crystal display components characterized by using as a principal component the base resin, the (B) curing agent, and (C) inorganic filler containing the oligomer which has one or more the functional groups and epoxy groups of radical reaction nature in 1 molecule, respectively.

[Claim 2] The sealant constituent for liquid crystal display components according to claim 1 characterized by the functional groups of radical reaction nature being an acryloyl radical and/or a methacryloyl radical.

[Claim 3] (B) The sealant constituent for liquid crystal display components according to claim 1 characterized by a curing agent containing organic peroxide, and an epoxy group and the compound which performs an addition reaction as an indispensable component.

[Claim 4] The liquid crystal display component using the sealant constituent for liquid crystal display components given in any 1 term of claims 1-3.

[Translation done.]

#### \* NOTICES \*

JPO and MCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.

  3.in the drawings, any words are not translated.

#### DETAILED DESCRIPTION

#### [Detailed Description of the Invention]

[Field of the Invention] This invention relates to the liquid crystal display component which used the sealant constituent for liquid crystal display components, and it.

[Field of the Invention] This invention relates to the liquid crystal display component which used the sealant constituent for liquid crystal display components, and it. [0002]
[Description of the Prior Art] In recent years, the liquid crystal display component has spread widely from the descriptions, such as a light weight, a thin shape, and a low power. The liquid crystal display component is carrying out sticking-by-pressure closure of the periphery section of the substrate of the glass of two sheets to which orientation processing was performed, or plastics with adhesives, and, generally is calling this the sealant for liquid crystal display components (omitting liquid crystal sealant). What made the epoxy resin the subject widely from current and this liquid crystal sealant being excellent in the electric dependability of a hardened material is used (for example, JP.59-12651 I.A). By the liquid crystal panel manufacturer, big screen-rization of a panel is advancing and efforts of much more productivity drive of LCD are continued in connection with this in recent years. The multistage pressurization hardening method which heats from a riswopiont of gap precision maintenance by accumulating two glass substrates stuck like the former is becoming difficult as panel size becomes large conventionally. Consequently, it is shifting to the sheet hardening method which heats by pressurizing two stuck glass substrates a lot every. Moreover, what can also harden a liquid crystal sealant from elegance conventionally in connection with it in a short time for the productivity drive of a panel is called for strongly. The conventional sealant hardening conditions had the common thing of 160-180 degrees C and 2 hours under panel pressurization. However, there is much what pursued short-time hardening rather than the present process the old place about what increased the quantity of the hardening accelerator which urges the ring breakage of an epoxy group and hardening accelerator which urges the ring breakage of an epoxy gr

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/cgi-bin/tran\_web\_cgi\_ejje

1/6 ページ

JP.10-003084.A [DETAILED DESCRIPTION]

3/6 ページ

epoxy resin, a glycidyl ester mold epoxy resin, cycloaliphatic epoxy resin, an urethane modified

epoxy resin, etc. (1008) As for a curing agent, it is desirable to contain organic peroxide, and an epoxy group and the compound which performs an addition reaction as an indispensable component, although especially the organic peroxide used by this invention is not limited — for example, discyl peroxide, peroxy discreptions, peroxy ester, peroxy ketal, diskyl peroxide, hydroperoxide, etc. — it is — one sort — or two or more sorts are used together and it is used. Moreover, as a compound which performs an epoxy group and an addition reaction, an amine system curing agent, an imidazole system curing agent, as disyndration ended to a hydrazide mold-curing agent, a phenol system curing agent, etc. are used as a hardening accelerator can also be further used together to these. Generally as a hardening accelerator, the Lyrn system compound, tertiary amine, an imidazole system compound, a urea mold compound, etc. are used.

tyrn system coulous, act any strains. See the carbonate of various metals, an alumina, a silica, titanium oxide, potassium titanate, etc. are mentioned, and it is desirable a kind or to use an alumina and a silica for two or more sorts from various points in these, using together. Furthermore, as an addition of an inorganic filler, it is desirable to consider as 3 – 50 % of the weight in all constituents from the point of workability, such as printing nature. [0010] Moreover, a solvent may be added if needed for the viscosity control of a sealant constituent and the purpose of homogeneity mixing of each component, although there is especially no limit about the class to be used — polyhydric alcohol, such as ester solvents, such as aromatic series system hydrocarbon system solvents, such as thydrocarbons, heaven on "Decara, and a cyclohexane, benzene, toluene, and a rylene, butyl acetate, and benzyl acetate, methyl cellosolve, butyl cellosolve, methyl carbitol, ethyl carbitol, methyl—cellosolve acetate, ethylene glycol, a diethylene glycol, and a jig lime the derivative of those, etc. — a kind — or two or more sorts be used together and it be used About the addition of a solvent, it is desirable to consider as 2 – 50 % of the weight in all constituents from points, such as printing nature.

used About the addition of a solvent, it is desirable to consider as 2 - 50 % of the weight in all constituents from points, such as printing nature. [O011] Furthermore, a coupling agent, a defoaming agent, a leveling agent, etc. may be added if needed other than a solvent. In case the liquid crystal sealant of this invention is adjusted, in order to make homogeneity mix each component, it is desirable to use and kneed 3 rolls etc. [O012] Generally as an approach of manufacturing a liquid crystal display component using the liquid crystal sealant of this invention, the following approaches are used. First, a seal pattern is formed in either the glass in which the liquid crystal orientation layer was formed, or a plastic plate, according to processes, such as screen-stencil. Since a solvent is included during a liquid crystal sealant presentation, after carrying out predrying with a drying furnace etc. another substrate is stuck, and is pressurized, an initial set is further finished with a drying furnace etc. on the conditions for 120-150 degrees C / 5 minutes, and proper gap maintenance of a liquid crystal plant is performed. Then, postcure is made to complete on the conditions of 150 more degrees C / 1 hour, where a pressure is canceled. Liquid crystal is injected into this stuck substrate. UV hardening resin etc. stops an inlet, and it considers as a liquid crystal display component.

[Example] Although the example of this invention is explained below, this invention is not limited

[Example] Although the example of this invention is explained below, this invention is not limited at all by these examples.

[0014] (Example 1) as an epoxy resin — a dicyclopentadiene mold epoxy resin (the Dainippon Ink & Chemicals, Inc. make —) the HP-7200 50 weight section and the bisphenol A mold epoxy resin (di-lized shell epoxy company make —) the oligomer (the Showa High Polymer Co., Ltd. make —) even each has oligomer and an acryloyl radical and an epoxy group every in both ends in the Epicant 828 il 0 weight section and the same molecule As the SP-1509H 40 weight section and as curing agent, adipic-acid dihydrazide (It abbreviates to ADH herafter) as 7 weight sections and organic peroxide — t-butyl peroxybenzoste (the Otsuke chemistry company make) (the Nippon Oil & Fats Co., Ltd. make —) The par butyl 23 weight section, the friend cure PN-R(Ajinomoto Co., Inc. make) 2 weight section which is an amine adduct mold polymer compound as a

curability with which shelf life, hardenability, an electrical property, etc. maintained balance synthetically is not yet carried out.

synthetically is not yet carried out. [0003] on the other hand, although the difference remarkable about an adhesive property was not seen when this invention persons are what blended the resin of radical reaction nature simply in the epoxy resin, and performed ingredient-tization and the liquid crystal sealant was hardened on the conditions for 120-150 degrees C / 5 minutes, it became clear that the electric dependability of a liquid crystal cell is alike and low. As a result of considering this cause in a detail, it became clear that the resin of the radical reaction nature which did not participate in bridge formation on the hardening conditions for 120-150 degrees C / 5 minutes was carrying out bleeding into liquid crystal from the liquid crystal sealant hardened material. On the other hand, the oligomer which has at least one or more the functional groups and epoxy groups of radical reaction nature in a molecule, respectively Even if the acryloyl radical and methacryloyl radical which do not participate in bridge formation even if exist it found out that are finally incorporated by the structure of cross linkage according to the hardening conditions of 150 radical which do not participate in bridge formation even if exist it found out that are finally incorporated by the structure of cross linkage according to the hardening conditions of 150 degrees C - 250 degrees C / 1 hour since the epoxy group is held in the same intramolecule and resin did not carry out bleeding into liquid crystal, and high electric dependability was acquired, and resulted in this invention.

[DOM] [Problem(s) to be Solved by the Invention] This invention completes an initial set under panel pressurization on the conditions for 120-150 degrees C / 5 minutes, holds a proper gap, and offers the liquid crystal sealant constituent characterized by the ability to complete postcure on condition that a short time of further 150-250 degrees C / 1 hour.

[Muns for Solving the Problem] This invention is a sealant constituent for liquid crystal display components characterized by using as a principal component the base resin, the (8) curing agent, and (C) inorganic filler containing the oligomer which has one or more the functional groups and epoxy groups of radical reaction nature in (A)1 molecule, respectively.

groups and epoxy groups of radical reaction nature in (A)1 molecule, respectively.

[0006]

[Embodiment of the Invention] The oligomer which is used as an indispensable component by this invention and which has one or more the functional groups and epoxy groups of radical reaction nature in 1 molecule, respectively combines radical reaction nature and the addition reaction nature by the epoxy group in the molecule. For this reason, hardening advances to extent which the radical generated on the conditions for bottom 120–150 degrees C / of panel pressurization, and 5 minutes reacts continuously, and can secure cel GYAPU from the organic peroxide used as a polymerization initiator. As loadings of this oligomer, they are below 80 weight sections more than 20 weight sections initiator. As loadings of this oligomer, they are below 80 weight sections more than 20 weight sections preferably below 90 weight sections more than 20 weight sections for bottom 120–150 degrees C / of panel pressurization, and 5 minutes is not obtained, the gap of a liquid crystal panel carnot be held, and it is not desirable. Furthermore, at an initial set, the epoxy group which hardly participated in a reaction completes an addition reaction on the conditions of 150 degrees C - 250 degrees C / 1 hour.

[0007] As for the functional group of the radical reaction nature in the oligomer which has one or more the functional groups and epoxy groups of radical reaction nature in 1 molecule, respectively used by this invention, it is desirable that they are an acryloyl radical and/or a methacryloyl radical. The disponer which is used by this invention and which has at least one or more the functional groups and epoxy groups of radical reaction nature in the aleast one or more the functional groups and epoxy groups. Although not limited especially about the class of epoxy resin which is a precursor before denaturation for example, the bisphenol A mold epoxy resin, an alkylation bisphenol A mold epoxy resin, a consideration of the poxy resin, a spici

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/cgi-bin/tran\_web\_cgi\_ejje

2006/02/02

JP.10-003084,A [DETAILED DESCRIPTION]

4/6 ページ

hardening scoelerator, The non-fixed form silics (product [ made from Japanese Aerosil ], Aerosil R-972) 5 weight section and the alumina (Showa Denko K.K. make, UA-5105) 30 weight section were carried out as an inorganic filler, stirring mixing of the ethyl jig lime 15 weight section was carried out as a solvent, it fully kneaded with 3 more roll, and the adhesives ent was obtained.

construent was obtained. (0015) Next, the rod-like spacer with a diameter of 8 micrometers was mixed 1% to this adhesives constituent, and the liquid crystal cell was produced in the following ways. (Screen-stencil) Line breadth screen-retenciled the pattern of the square which is 0.3mm on the glass substrate with ITO in which the orientation film was made to form using the version of 300 microscreen. eshes (one-side square of 3cm).

meshes (one-side square of 3cm). (Fredying) Predying was carried out during hot air drying for 90 degrees C / 30 minutes. (Lamination/heat hardening) Where lamination and the pressure of 1kg/cm2 are put for the direction of orientation to become 90 degrees to the orientation processing direction of the substrate within printed the sealant about the glass substrate with ITO in which the orientation film was made to form, the initial set was carried out for 140 degrees C in hot air drying equipment / 5 minutes. This was cooled to the room temperature, and where a pressure is canceled, postcure was performed for 150 degrees C / 1 hour. In addition, the evaluation cel was produced each =10. produced each n=10.

produced each n=10.

(Liquid crystal impregnation / obturation) Fluorine system liquid crystal (the Merck Co. make, ZLI-4792) was poured in, and the inlet was obturated with acrylic UV hardening resin.

[0016] Evaluation was performed as follows. 127⋅(a) and the above-mentioned liquid crystal display component are left in the pressure cooker tester set as 125 degree—C/2.3atm. After processing finished, the electrical-potential-difference retention of this liquid crystal cell and the existence of exfoliation of a seal part were checked. The result of evaluation is as being shown

|       | 世氏保持事 (%) | シール体網部の有無 |  |  |
|-------|-----------|-----------|--|--|
| 尖路舞 1 | 98        | #L        |  |  |
| 卖施何2  | 98        | 無し        |  |  |
| 典職何3  | 9.8       | ЖL        |  |  |
| 比较例 1 | 8 2       | 有り        |  |  |
| 比較何2  | 8.5       | # 9       |  |  |
| 比較何3  | 8 3       | 有り        |  |  |

(018) (Example 2) as an epoxy resin — a dicyclopentadiene mold epoxy resin (the Dainippon Ink & Chemicals, Inc. make —) the HP-7200 40 weight section and the bisphenol A mold epoxy resin (oil-ized shell epoxy company make —) the oligomer (the Showa High Polymer Co., Ltd. make —) even each has oligomer and an acryloyl radical and an epoxy group ever yin both ends in the Epicost 1001 20 weight section and the same molecule As the SP-1509H 40 weight section and a curing agent, the ADH/Otsuka chemistry company make) 7 weight section, as organie peroxide—a cumene hydroperoxide (the Nippon Oil & Fats Co., Ltd. make —) The Park Mill H4 weight section, the friend cure MY-R/Ajinomoto Co., Inc. make) 2 weight section which is an amine adduct mold polymer compound as a hardening accelerator, The non-fixed form slice foroduct [made from Japanese Aerosil ]. Aerosil R-972) 5 weight section and the alumina (Showa Derko K.K. make, UA-5105) 30 weight section were carried out as an inorganic filler, string mixing of the ethyl jig lime 20 weight section was carried out as a solvent, it fully kneaded with 3 more roll, and the adhesives constituent was obtained. The result of evaluation is as being shown in Table 1.

[0019] (Example 3) as an epoxy resin — a naphthalene mold epoxy resin (the Dainippon Ink &

Chemicals, Inc. make —) the HP-4032 40 weight section and the bisphenol A mold epoxy resin (oil-ized shell epoxy company make —) the oligomer (the Nippon Oil & Fats Co., Ltd. make —) even each has oligomer and a methacryloyl radical and an epoxy group every in both ends in the Epicost 1001 20 weight section and the same molecule As the BUREMMA GH40 weight section

Chemicals, Inc. make —) the HP-4032 40 weight section and the bispherol A mole opoxy resn (oli-ized shell epoxy company make —) the oligomer (the Nippon Oil & Fats Co., Ltd. make —) even each has oligomer and a methacryloyl radical and an epoxy group every in both ends in the Epicost 1001 20 weight section and the same molecule As the BUREMMA GH40 weight section, as organic peroxide — tert-butyl peroxide 2-ethythoxanosta (the Nippon Oil & Fats Co., Ltd. make —). The par butyl O4 weight section, the friend cure MY-FR(Ajinomoto Co., Inc. make) 2 weight section which is an amine adduct mold polymer compound as a hardening accelerator. The nonfixed form silica (product [ made from Japanese Aerosil]. Aerosil R-972) 5 weight section and the alumina (Showa Denko K.K. make, UA-5105) 30 weight section were carried out as a solvent, it fully kneaded with 3 more roll, and the adhesives constituent was obtained. The result of evaluation is as being shown in Table 1. (0020) (Example 1 of a companison) as an epoxy resin — a dicyclopentadiene mold epoxy resin (the Dainippon lak & Chemicals, Inc. make —) the HP-7200 50 weight section and the bisphenol A mold epoxy resin (che Dainippon lak & Chemicals, Inc. make —) the HP-7200 50 weight section and the bisphenol A mold epoxy resin (che Dainippon lak & Chemicals, Inc. make —) the HP-7200 50 weight section and the bisphenol A mold epoxy resin (che Dainippon lak & Chemicals, Inc. make —) the HP-7200 50 weight section and break bisphenol A mold epoxy resin (che Dainippon lak & Chemicals, Inc. make —) the HP-7200 50 weight section and break bisphenol A mold epoxy resin (che Dainippon lak & Chemicals, Inc. make —) the HP-7200 50 weight section and break bisphenol A mold epoxy resin (che Dainippon lak & Chemicals, Inc. make —) the HP-7200 40 weight section and break bisphenol A mold epoxy resin (che Dainippon lak & Chemicals, Inc. make —) weight section and the alumina (Showa Denko K.K. make, UA-5105) 30 weight section was carried out as a repoxy resin (che Dainippon lak & Chemicals,

[UC23] [Effect of the Invention] According to this invention, an initial set is completed under panel pressurization on the conditions for 120-150 degrees C / 5 minutes, a proper gap can be held,

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/cgi-bin/tran\_web\_cgi\_ejje 2006/02/02 postcure can be completed on condition that a short time of further 150-250 degrees C / 1 hour, and the productivity drive of a liquid crystal panel can be planned.

[Translation done.]

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/cgi-bin/tran\_web\_cgi\_ejje

2006/02/02